

2024-2030年中国薄膜沉积 设备产业发展现状与市场调查预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国薄膜沉积设备产业发展现状与市场调查预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202310/414161.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

薄膜沉积工艺是半导体制造中的关键工艺。半导体行业中，薄膜常用于产生导电层或绝缘层、产生减反射膜提高吸光率、临时阻挡刻蚀等作用，由于薄膜是芯片结构的功能材料层，在芯片完成制造、封测等工序后会留存在芯片中，薄膜的技术参数直接影响芯片性能。由于半导体器件的高精度，薄膜通常使用薄膜沉积工艺来实现，晶圆表面的沉积物会在晶圆表面形成一层连续密闭的薄膜。薄膜沉积设备通常用于在基底上沉积导体、绝缘体或者半导体等材料膜层，使之具备一定的特殊性能，广泛应用于光伏、半导体等领域的生产制造环节。

2022年全球半导体设备市场规模为1085亿美元，创下历史新高，分析人士指出，在连增三年之后，2023年负增长隐忧显现。但寒意或许“冷”不到国产半导体设备厂商。A股半导体设备公司2022年业绩表现亮眼，北方华创、拓荆科技、芯源微等净利同比翻倍。与全球半导体设备支出大体跟随全球半导体资本支出周期的变化相反，国产半导体设备支出由于持续的本土化进程推进而与半导体资本支出周期脱钩，更具韧性。北方华创、拓荆科技、芯源微、华海清科、长川科技、盛美上海等六家A股半导体设备公司2022年业绩同比增速上限大于100%，其中薄膜沉积设备国产领军者拓荆科技以438%的同比增速排名第一。

SEMI数据显示，2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升，从21%提升至35%。2022年，在半导体设备各细分领域，薄膜沉积设备国产化率约为8%。

政策方面，2022年3月，在第十三届全国人民代表大会第五次会议上，其中提到加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。2022年10月，国家发展改革委和商务部联合发布了《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，其中将“超大规模集成电路制造用关键装备开发、制造”、“集成电路封装及测试设备制造”以及“晶圆制造及再生”列入鼓励类目录。国家政策鼓励国内半导体行业内企业向更先进技术水平、更广泛市场领域、更底层核心技术等方面砥砺前行，完善和发展我国半导体产业水平，为薄膜沉积设备行业提供良好的发展环境。

中企顾问网发布的《2024-2030年中国薄膜沉积设备产业发展现状与市场调查预测报告》共十一章。首先，报告介绍了薄膜沉积设备行业的相关概念、半导体设备发展情况，接着，对中国薄膜沉积设备行业发展的宏观环境以及薄膜沉积设备行业发展状况作了分析。然后报告分析了薄膜沉积设备的相关技术、进出口情况以及主要应用领域发展情况；接下来，报告对国内外重点企业经营状况进行了详细分析；随后对薄膜沉积设备行业投资进行了分析，并对薄膜沉积设备行业的发展前景进行了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、工信部、半导体行业协会、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析

预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对薄膜沉积设备行业有个系统深入的了解、或者想投资薄膜沉积设备相关项目，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

报告目录：

第一章 薄膜沉积设备行业相关概述

1.1 半导体设备行业相关概念

1.1.1 行业基本概念

1.1.2 行业主要分类

1.1.3 投资价值占比

1.2 薄膜沉积设备行业基本介绍

1.2.1 行业基本概念

1.2.2 行业主要类别

1.2.3 设备技术对比

第二章 2021-2023年半导体设备行业发展综合分析

2.1 2021-2023年全球半导体设备行业发展状况

2.1.1 市场规模状况

2.1.2 市场区域分布

2.1.3 市场产品结构

2.1.4 企业竞争格局

2.1.5 行业投资状况

2.2 2021-2023年中国半导体设备行业发展分析

2.2.1 市场规模状况

2.2.2 国产化率情况

2.2.3 企业产品布局

2.2.4 企业营收排名

2.2.5 对外贸易状况

2.3 中国半导体设备行业上市公司财务状况

2.3.1 上市公司规模

2.3.2 上市公司分布

2.3.3 经营状况分析

- 2.3.4 盈利能力分析
- 2.3.5 营运能力分析
- 2.3.6 成长能力分析
- 2.3.7 现金流量分析
- 2.4 中国半导体设备行业发展展望
 - 2.4.1 行业发展路径
 - 2.4.2 市场需求潜力
 - 2.4.3 行业发展前景

第三章 2021-2023年中国薄膜沉积设备行业发展环境分析

- 3.1 政策环境
 - 3.1.1 行业监管主体部门
 - 3.1.2 行业相关发展政策
 - 3.1.3 企业税收优惠政策
 - 3.1.4 产业投资基金支持
- 3.2 经济环境
 - 3.2.1 世界经济形势分析
 - 3.2.2 国内宏观经济概况
 - 3.2.3 工业经济运行情况
 - 3.2.4 固定资产投资状况
 - 3.2.5 国内宏观经济展望
- 3.3 社会环境
 - 3.3.1 数字经济发展基础
 - 3.3.2 电子信息产业运行
 - 3.3.3 科技研发投入状况
 - 3.3.4 技术人才培养情况

第四章 2021-2023年薄膜沉积设备行业发展综合分析

- 4.1 2021-2023年全球薄膜沉积设备行业发展状况
 - 4.1.1 全球市场规模
 - 4.1.2 全球市场结构
 - 4.1.3 全球竞争格局

4.2 2021-2023年中国薄膜沉积设备行业发展状况

4.2.1 国内主要厂商

4.2.2 国内中标情况

4.2.3 国产化率情况

4.2.4 国内需求分析

4.3 2021-2023年CVD设备行业发展分析

4.3.1 行业基本概念

4.3.2 产业链条结构

4.3.3 市场规模状况

4.3.4 市场结构占比

4.3.5 市场竞争格局

4.3.6 细分市场格局

4.4 2021-2023年PVD设备行业发展分析

4.4.1 行业基本概念

4.4.2 工艺类型对比

4.4.3 产业链条分析

4.4.4 行业产值规模

4.4.5 市场规模状况

4.4.6 市场区域结构

4.4.7 市场竞争格局

第五章 薄膜沉积设备行业相关技术发展分析

5.1 物理气相沉积技术发展分析

5.1.1 技术基本简介

5.1.2 技术基本分类

5.1.3 技术研究进展

5.1.4 技术应用状况

5.1.5 未来发展展望

5.2 化学气相沉积技术研究与应用进展

5.2.1 化学气相沉积技术原理

5.2.2 先进集成电路工艺应用

5.2.3 其他领域技术应用状况

5.3 原子层沉积技术发展分析

5.3.1 技术基本原理

5.3.2 技术发展优点

5.3.3 关键技术分析

5.3.4 技术应用状况

第六章 2021-2023年中国薄膜沉积设备行业相关进出口数据分析

6.1 2021-2023年中国制造半导体器件或IC的化学气相沉积装置进出口数据分析

6.1.1 进出口总量数据分析

6.1.2 主要贸易国进出口情况分析

6.1.3 主要省市进出口情况分析

6.2 2021-2023年中国制造半导体器件或IC的物理气相沉积装置进出口数据分析

6.2.1 进出口总量数据分析

6.2.2 主要贸易国进出口情况分析

6.2.3 主要省市进出口情况分析

6.3 2021-2023年中国制造半导体器件或IC的物理气相沉积装置进出口数据分析

6.3.1 进出口总量数据分析

6.3.2 主要贸易国进出口情况分析

6.3.3 主要省市进出口情况分析

第七章 2021-2023年薄膜沉积设备主要应用领域发展综合分析

7.1 集成电路领域

7.1.1 集成电路产业销售规模

7.1.2 集成电路产量规模分析

7.1.3 集成电路产业结构分布

7.1.4 集成电路企业注册数量

7.1.5 集成电路产业贸易状况

7.1.6 薄膜沉积设备应用前景

7.2 光伏电池领域

7.2.1 光伏电池产业发展背景

7.2.2 光伏电池行业基本概述

7.2.3 光伏电池行业产量规模

- 7.2.4 光伏电池转换效率变化
- 7.2.5 光伏电池技术路线占比
- 7.2.6 光伏电池企业数量规模
- 7.2.7 薄膜沉积设备应用情况
- 7.2.8 薄膜沉积设备发展前景
- 7.3 新型显示领域
 - 7.3.1 新型显示产业政策
 - 7.3.2 新型显示主要技术对比
 - 7.3.3 新型显示产业营业收入
 - 7.3.4 新型显示细分市场发展
 - 7.3.5 新型显示未来发展趋势
 - 7.3.6 薄膜沉积设备应用前景
- 7.4 先进封装领域
 - 7.4.1 先进封装产业发展背景
 - 7.4.2 先进封装行业基本概述
 - 7.4.3 先进封装行业发展历程
 - 7.4.4 先进封装市场规模状况
 - 7.4.5 先进封装行业所需设备
 - 7.4.6 先进封装技术发展展望
 - 7.4.7 薄膜沉积设备应用前景

第八章 2021-2023年国外薄膜沉积设备行业重点企业经营状况分析

- 8.1 应用材料（AMAT）
 - 8.1.1 企业发展概况
 - 8.1.2 沉积设备布局
 - 8.1.3 2021年企业经营状况分析
 - 8.1.4 2022年企业经营状况分析
 - 8.1.5 2023年企业经营状况分析
- 8.2 泛林半导体（Lam）
 - 8.2.1 企业发展概况
 - 8.2.2 沉积设备布局
 - 8.2.3 2021年企业经营状况分析

- 8.2.4 2022年企业经营状况分析
- 8.2.5 2023年企业经营状况分析
- 8.3 东京电子（TEL）
- 8.3.1 企业发展概况
- 8.3.2 沉积设备布局
- 8.3.3 2021年企业经营状况分析
- 8.3.4 2022年企业经营状况分析
- 8.3.5 2023年企业经营状况分析
- 8.4 先晶半导体（ASMI）
- 8.4.1 企业发展概况
- 8.4.2 沉积设备布局
- 8.4.3 2021年企业经营状况分析
- 8.4.4 2022年企业经营状况分析
- 8.4.5 2023年企业经营状况分析

第九章 2020-2023年中国薄膜沉积设备行业重点企业经营状况分析

9.1 北方华创科技集团股份有限公司

- 9.1.1 企业发展概况
- 9.1.2 企业业务状况
- 9.1.3 沉积设备布局
- 9.1.4 经营效益分析
- 9.1.5 业务经营分析
- 9.1.6 财务状况分析
- 9.1.7 核心竞争力分析
- 9.1.8 公司发展战略
- 9.1.9 未来前景展望

9.2 拓荆科技股份有限公司

- 9.2.1 企业发展概况
- 9.2.2 沉积设备布局
- 9.2.3 经营效益分析
- 9.2.4 业务经营分析
- 9.2.5 财务状况分析

- 9.2.6 核心竞争力分析
- 9.2.7 公司发展战略
- 9.2.8 未来前景展望
- 9.3 中微半导体设备（上海）股份有限公司
 - 9.3.1 企业发展概况
 - 9.3.2 沉积设备布局
 - 9.3.3 经营效益分析
 - 9.3.4 业务经营分析
 - 9.3.5 财务状况分析
 - 9.3.6 核心竞争力分析
 - 9.3.7 公司发展战略
 - 9.3.8 未来前景展望
- 9.4 盛美半导体设备（上海）股份有限公司
 - 9.4.1 企业发展概况
 - 9.4.2 沉积设备布局
 - 9.4.3 经营效益分析
 - 9.4.4 业务经营分析
 - 9.4.5 财务状况分析
 - 9.4.6 核心竞争力分析
 - 9.4.7 公司发展战略
 - 9.4.8 未来前景展望
- 9.5 江苏微导纳米科技股份有限公司
 - 9.5.1 企业发展概况
 - 9.5.2 主要产品情况
 - 9.5.3 竞争优劣势分析
 - 9.5.4 业务布局状况
 - 9.5.5 企业发展动态
 - 9.5.6 未来发展战略

第十章 中国薄膜沉积设备行业典型项目投资建设深度解析

- 10.1 高端半导体设备扩产项目
 - 10.1.1 项目基本概况

- 10.1.2 项目投资必要性
- 10.1.3 项目投资可行性
- 10.1.4 项目投资概算
- 10.1.5 项目建设安排
- 10.2 先进半导体设备的技术研发与改进项目
 - 10.2.1 项目基本概况
 - 10.2.2 项目投资目的
 - 10.2.3 项目投资概算
 - 10.2.4 项目建设安排
 - 10.2.5 项目选址情况
- 10.3 ALD设备研发与产业化项目
 - 10.3.1 项目基本概况
 - 10.3.2 项目投资目的
 - 10.3.3 项目投资概算
 - 10.3.4 项目建设安排
 - 10.3.5 项目选址情况
- 10.4 基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目
 - 10.4.1 项目基本概况
 - 10.4.2 项目投资必要性
 - 10.4.3 项目投资可行性
 - 10.4.4 项目投资概算
 - 10.4.5 项目进度安排
- 10.5 基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目
 - 10.5.1 项目基本概况
 - 10.5.2 项目投资目的
 - 10.5.3 项目投资概算
 - 10.5.4 项目进度安排
 - 10.5.5 项目选址情况

第十一章 2024-2030年中国薄膜沉积设备行业投资分析及前景预测

- 11.1 中国薄膜沉积设备行业投资分析
 - 11.1.1 行业投资机会

- 11.1.2 企业上市情况
- 11.1.3 行业投资壁垒
- 11.1.4 行业投资风险
- 11.1.5 企业投资策略
- 11.2 中国薄膜沉积设备行业发展前景分析
 - 11.2.1 行业发展机遇
 - 11.2.2 未来发展方向
 - 11.2.3 行业发展趋势
- 11.3 2024-2030年中国薄膜沉积设备行业预测分析
 - 11.3.1 2024-2030年中国薄膜沉积设备行业影响因素分析
 - 11.3.2 2024-2030年全球薄膜沉积设备市场规模预测
 - 11.3.3 2024-2030年中国CVD设备市场规模预测

图表目录

- 图表 集成电路产业链
- 图表 集成电路前道制造工艺流程主要设备
- 图表 主要半导体设备分类示意图
- 图表 半导体设备投资占比情况
- 图表 薄膜沉积设备分类
- 图表 PVD、CVD、ALD薄膜沉积效果示意图
- 图表 PVD、CVD、ALD技术优劣势及主要应用领域
- 图表 2015-2021年全球半导体设备市场规模及增长率
- 图表 2021年全球半导体设备主要国家销售额分布
- 图表 2021年全球半导体设备细分类型结构占比
- 图表 全球半导体设备代表性企业
- 图表 2021年全球前十五大半导体设备厂商
- 图表 2017-2022年全球半导体设备行业投资状况
- 图表 2015-2021年中国半导体设备市场规模及增长率
- 图表 2021年中国半导体设备国产化占比情况
- 图表 2020年中国半导体设备与原材料国产化率
- 图表 国内半导体设备企业产品布局
- 图表 2021年国内上市公司半导体设备业务营收排名Top10

图表 2017-2021年中国主要半导体设备进口额

图表 半导体设备行业上市公司名单

图表 2018-2022年半导体设备行业上市公司资产规模及结构

图表 半导体设备行业上市公司上市板分布情况

图表 半导体设备行业上市公司地域分布情况

图表 2018-2022年半导体设备行业上市公司营业收入及增长率

图表 2018-2022年半导体设备行业上市公司净利润及增长率

图表 2018-2022年半导体设备行业上市公司毛利率与净利率

图表 2018-2022年半导体设备行业上市公司营运能力指标

图表 2022-2023年半导体设备行业上市公司营运能力指标

图表 2018-2022年半导体设备行业上市公司成长能力指标

图表 2022-2023年半导体设备行业上市公司成长能力指标

图表 2018-2022年半导体设备行业上市公司销售商品收到的现金占比

图表 2020-2022年中国薄膜沉积设备行业相关政策汇总

图表 一期大基金投资各领域份额占比

图表 国家集成电路产业基金二期出资方（一）

图表 国家集成电路产业基金二期出资方（二）

图表 国家集成电路产业投资基金二期投资方向

图表 大基金一期与大基金二期对比

图表 2018-2022年国内生产总值及其增长速度

图表 2018-2022年三次产业增加值占国内生产总值比重

图表 2018-2022年全部工业增加值及其增长速度

图表 2022年主要工业产品产量及其增长速度

图表 2023年全国规模以上工业增加值同比增长速度

图表 2023年全国规模以上工业生产主要数据

图表 2021年全国三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重

图表 2021年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度

图表 2021年固定资产投资新增主要生产与运营能力

图表 2022年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重

图表 2022年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度

图表 2022年固定资产投资新增主要生产与运营能力

图表 2023年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重

图表 2023年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度

图表 2023年固定资产投资新增主要生产与运营能力

图表 2021-2022年电子信息制造业和工业增加值累计增速

图表 2021-2022年电子信息制造业和工业出口交货值累计增速

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202310/414161.html>